



# 一般社団法人日本半導体製造装置協会

## 『平成 30 年賀詞交歓会』

主 催： 一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (SEAJ)

〒102-0085 東京都千代田区六番町 3 番地 六番町 SK ビル 6F



I. 日 時： 平成 30 年 1 月 11 日 (木) 18:00～19:30

II. 場 所： 如水会館 2階「スターホール」  
東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 TEL 03(3261)1101

III. お申込方法：お申込期限 12月25日(月)迄  
お手数ですが、お申込者(当協会に別紙申込書をお送り頂く方)がご参加者を取りまとめて頂き、同封の申込書により FAXにてお申込ください。  
後日お申込者宛に名札及び請求書をお送り致します。  
なお、誠に勝手ながらキャンセルはお受けいたしかねますので、ご都合が悪い場合は代理の方のご出席をお願い申し上げます。

IV. 会 費： 10,800円/お一人様

◆ お申込の方は名札と一緒に請求書をお送り申し上げますので、お手数ですが、後日指定口座にお振込み下さい。

お問合せ先 一般社団法人 日本半導体製造装置協会

総務部：星野、瀬戸 経理：吉田

TEL：03-3261-8260

FAX：03-3261-8263

E-mail：[info@seaj.or.jp](mailto:info@seaj.or.jp)